精选快讯　金融快讯　2026年11月12日 09:52

三星电子在牙山温阳动工HBM封装厂，计划投资6万亿韩元建设

要点

- 12日，韩国总统Lee Jae Myung与三星电子会长Lee Jae-yong出席了在忠清南道牙山三星电子温阳园区举行的先进高带宽内存（HBM）封装厂动工仪式。
- 三星电子计划投资6万亿韩元建设这座新工厂，并在未来推进约40万亿韩元的先进设备投资。
- 动工仪式场地附近，三星电子同行工会举行抗议。

12日，韩国总统Lee Jae Myung与三星电子会长Lee Jae-yong出席了在忠清南道牙山三星电子温阳园区举行的先进高带宽内存（HBM）封装厂动工仪式。Lee Jae-yong在欢迎致辞中表示，此前以半导体封装和测试为主的温阳园区将转型为先进HBM生产基地。

三星电子计划投资6万亿韩元建设这座新工厂，并在未来推进约40万亿韩元的先进设备投资。

动工仪式场地附近，三星电子同行工会举行抗议。该工会主张，约5万名设备体验（DX）部门员工被排除在谈判之外，抗议者举着写有“Lee Jae-yong会长，请和我们对话”等标语的牌子。工会称，在今年工资谈判中，以半导体设备解决方案（DS）部门为中心的谈判代表工会主导了谈判，未充分反映DX员工的诉求。工会要求公司就2026年工资谈判中排除DX部门正式道歉，引入有意义的现金激励措施，并为2027年建立公平的共同谈判框架。Son Yong-ho表示，工会向Lee Jae-yong提出的要求是负责任的对话，并非特殊待遇，并称在公司提出实质性解决方案前将继续现场抗议。

报道来源：newstomato、widedaily、4th、chosun、newsfield、financialpost

来源网站：https://www.inews.today/